DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

3333662

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 56023748 A2 810306 < No. of Patents: 002>

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE (English)

Patent Assignee: YAMAZAKI SHIYUNPEI Author (Inventor): YAMAZAKI SHIYUNPEI

IPC: \*H01L-021/324; H01L-021/268 CA Abstract No: \*99(04)031794K; Derwent WPI Acc No: \*C 81-29944D; JAPIO Reference No: \*050074E000098;

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

**JP 56023748** A2 810306 JP 7999742 A 790805 (BASIC)

JP 83008128 B4 830214 JP 7999742 A 790805

Priority Data (No,Kind,Date): JP 7999742 A 790805 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

00703448

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

PUB. NO.:

**56-023748** [JP 56023748 A]

PUBLISHED:

March 06, 1981 (19810306)

INVENTOR(s): YAMAZAKI SHUNPEI

APPLICANT(s): YAMAZAKI SHUNPEI [000000] (An Individual), JP (Japan)

APPL. NO.:

54-099742 [JP 7999742]

FILED:

August 05, 1979 (19790805)

INTL CLASS:

[3] H01L-021/324; H01L-021/268

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 14.2 (ORGANIC

CHEMISTRY -- High Polymer Molecular Compounds); 35.1 (NEW

**ENERGY SOURCES -- Solar Heat)** 

JAPIO KEYWORD:R002 (LASERS); R004 (PLASMA); R096 (ELECTRONIC MATERIALS

Glass Conductors); R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS); R100 (ELECTRONIC MATERIALS -- Ion

Implantation); R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant Resins);

R124 (CHEMISTRY -- Epoxy Resins)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 57, Vol. 05, No. 74, Pg. 98, May 16,

1981 (19810516)

### **ABSTRACT**

PURPOSE: To eliminate or reduce the density of recombination center or crystal defects in the semiconductor device by optically annealing the surface of semiconductor with laser or the like, and optically annealing it in atmosphere added with halogen element or inert gas to H(sub 2) or He activated.

CONSTITUTION: An Si substrate is irradiated with CW laser of 70W power or the like to anneal the layer of approximately 3.mu.. Then, it is contained in an atmosphere added with 30-70% of He to H(sub 2) or H(sub 2), or with 0.1-3% of halogen element such as F or the like in furnace, and the furnace is excited by high frequency induction of 1-100MHz at -70 deg.C-+200 deg.C. The H of nascent state is immersed without any trouble to combine with Si or O(sub 2) existed in the semiconductor, insulator or their boundary to neutralize it. In this manner it is laser annealed, and then induction annealed to neutralize the defect which cannot be treated by the laser annealing in depth so as to improve the property of the device very effectively.

# (B) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# <sup>10</sup> 公開特許公報(A)

昭56-23748

①Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 L 21/324 21/268

識別記号

庁内整理番号 6684-5F 6684-5F ❸公開 昭和56年(1981) 3 月,6 日

発明の数 2 審査請求 有

(全 7 頁)

# **99半導体装置作製方法**

创特

顧 昭54--99742

**20**HH

願 昭54(1979)8月5日

@発 明 者 山崎舜平

東京都世田谷区北烏山7丁目21 番21号

⑪出 願 人 山崎舜平

東京都世田谷区北烏山7丁目21

番21号

明 細 書

1.発明の名称

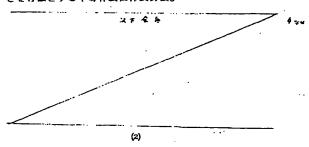
牛導体装置作製方法

#### 2.特許請求の範囲・

- 2. 半導体の一表面にレーザまたはその種の強光エネルギを (基準) 原射して前記半導体をアニールした後、活性化させた水素、(基別のでは、100円では、10
- 3. 特許請求の範囲第1項および第2項において、固相エピター・クキンアル皮長を行なわしめる 完装レーザアニール 発売 がなされたことを特徴とした半導体装置作製方法。
  - 4. 特許請求の範囲第1項および第2項において、被根エビ

タ中シャル成長を行なわしめる全統発設レーザナニールがな 3 本がされたことを特徴とする半導体装置作製方法。

- 5. 特許請求の範囲第2項において、光アニールの③300〜 700°cでの無アニールを行ない、さらにその後誘導アニー ルを行なりことを普載とした半導体装置作製方法。
- 6. 特許請求の範囲第1項シよび第2項において、幸導体は基板上に形成された非単結晶半導体が用いられたととを特徴とする半導体製量作製方法。
- 7. 特許請求の範囲第1項および第2項において、被照射体は 非単結晶半導体の上面または下面に透明電便が設けられたと とを特徴とする半導体装置作製方法。



(2)

#### 3.発明の詳細な説明

本発明は、半導体の一表面にレーザまたはその他の激光エネルギを照射して、前記半導体の表面またはその近傍をアニールするにもかかわらず、光アニールによつて消滅させ得ない再結合中心密度または結晶欠陥の密度を消滅または減少させるため活性化させた水素または水素にハログン元素または不活性ガスが添加された雰囲気中で光アニールを行なりことを目的にして

本発明は、光アニールを行なつた後、高周波揚導さたはマイクロ波勝溥の知き電気エデルギにより化学的に活性化された水 1700年 1870年 18

(3)

従来より半減体装置に発生した再結合中心または単位に対しては熱アニールがその密度を減少さそる方法として知られている。これは300~700°Cの温度にかける水素または不活性ガス中にかけるアニール(徐熱)により、半導体特に単結晶半導体またはこの上部に絶縁ゲイト型電界効果半導体装置等のゲイト絶象物を設けたいわゆるMIS構造(金属一絶縁物特に酸化珪素一半導体特に珪素)の半導体装置にかいて、界面のかそい単位を相殺したりまたは単結晶半導体中の格子面を徐去していた。

また高温アニールとして700~1200°C 例えば1000°C いかにより単結晶半導体中にホウ素的、リン的、ヒ素(40) 等を注入し、その後のアニールにより、この注入により発生した無定形状態をもとあつた如く単結晶化することが知られている。

しかしこれらのいずれにおいても、その基本思想においては より単結晶化することによりその結晶中の不対結合手またはペ イカンシを前載させることを前提としているものである。

本売別はかかる従来より知られたるアニール方法ではなく、 レーザ先またはそれと同様の強売エネルギ(以下移称してモー 行をい半導体の結晶粒径または塊径を大きくしひいては再結合 中心密度を減少せしめるととを目的としている。

本発明は半導体が形成されている基板が単鉛品材料またはその上面にうすく形成された絶縁物よりなる材料において、液相 エピタキシアル成長を行なわしめることにより半導体をより完 全な単結晶とすることを目的としている。

本発明は、光アニールを行なりことにより半導体中にアコ接合を連続的に設け半導体装置例えばパイポーラトランジスタ、 MIS・アBTを単体または集積化して作製し、そのすべてが 完成した後、誘導アニールによりこの半導体装置全体に活性水 素を注入してキャリアの再結合中心になる不対結合手またはミューションな格子欠陥を電気的に中性化してしまりことを目的として いる。

本発明は光アニールを行なうととにより半導体表面とその上面の電極等に透明電極とを一体化し、その境界領域においてそれらの成分元素を添加せしめ電極下の半導体層の電気伝導度の向上と半導体中への多量のポロン等の不統物ドーブによるキャリアの情報を防止するととにより光一電気変換効率を向上せしめる光電変換装置等に太陽電池を有効に行なわしめる特徴をもつ。

アニールという)を半導体に加え、その結果半導体特に半導体 表面またはその近傍の半導体をキュアせんとしたものである。

さらに本発明はかかるL-アニールが単結晶よりも非単結晶 に対して有効であり、かつこの非単結晶すなわらCVD法等の 方法により基板上に形成させたと結晶またはアモルファス半導 体、またはグロー放電法、プラズマCVD法等により形成され た水素を含有したアモルフアスまたは結晶粒径が10~1004 の数少径を有する多結晶に対して特に有効である。

かかる非単結晶半導体はきわめて多数の不対結合手を一般に有しているため、不純物が10~10~10の多量にドープされた実質的に導体として用いる場合、またはかかる非単結晶半導体中にその被腹の形成と同時にその不対結合手と水楽とを結合させて中和させることにより半導体として用いる場合が知られている。しかし前者に関してはその不純物の量を1000㎡~50~10~1000㎡~50~1000円であると多量にドープするとその不純物が折出しいわゆる個折をかとし、不純物の塊を半導体中に発生させ電気的に何ら活性にならなくなつてしまう。すなわらその半導体中での活性度(半導体中のアまたは単型に活性になった量/半導体中に温

(5)

特屈昭56- 23748(3)

入している不純物の量)がきわめて0.1~10号程度と低く なつてしまつた。また他方水素がドープされた乗単結晶手導体 にあつては、その系を電極を形成したりさらに低い温度でのアパパッ ニール300~700°Cを行なうと、その半導体中の水素は水 素化物例をは81一旦結合より遊離し、半導体中より外へ旦と して放出されてしまい、熱アニールによりかえつて再結合中心 の密度が大きくなつてしまつた。

加えて本発明はエーアニールの際半導体上表面に形成される 電極等に透明電極中の森加物またはその構成元素の一部を半導 体中に移動させ、その境界面をとれまでの面の概念より領域の 概念にまで拡大したことを特徴としている。その結果、かかる 電極下の半導体は不純物の活性度が高められ、かつその電気伝 導度がきわめて大きく金属と同程度に近り伝導度を有する。す なわちフェルミレベルが実質的に縮遠した状態にまでさせるこ とができるよりになつた。

以下に本発明の実施例を図面に従つて説明する。

第1図は本発明に用いられた半導体装置の実施例である。
第1図(A)に半導体基板(I)を示している。との半導体基板は発 素等の単結晶半導体がその代要例である。との単結晶半導体は その上表部にNIB構造が設けられていても、また半導体基板 の一部にイオン注入等により不納物がドープされていて紀分的 に非単結晶になつていてもよい。本発明はかかる半導体に対し Lーアニールを行なつた。Lーアニールに用いられたレーザは CNレーザを用いた。出力は10~90Nであつた。ミラーを 用いて位置を連続的にスキアンさせた。かくすることにより半 導体基板表面の五傍0・1~3×0深さの半導体層がアニール された。しかしこのLーアニールは半導体一絶線膜界面にては

(8)

その近傍にある界面準位の高級にはちまり効果がなかつた。加 ・ 10 min とて半導体中を流れる少数キャリアによる微少電流に対しては、「であい ・ 5 まり有効でなかつた。

その結果、イオン在入券により破壊されていた半導体層は欠 陥密度は10cm。より10~10cmにまで下げることができ それをさらに1/10~1/50に下げることができた。 符に レーザアニールが例えばMIB・PRIのソース、ドレインを 様成する不純物層の欠陥密度のその接合部を広げることなく可 能であるのに対し、誘導アニールはこの接合部またはこの近傍 または半導体と絶縁膜との界面での不対対合手・準位を少くさ せることに効果があつた。また加えてレーザアニールが界面上 により近い領域のアニールであるのに対し、このレーアニール により処理しきれない半導体表面より3~10 Pと深い位置で の欠陥を中和させてアニールを行なうため誘導アニールはきわ めて有効であつた。

第1回回は基板の上に半導体層()を形成させたものである。
この半導体または半導体層はシラン等の硅化物全体による協分
解法を利用して500~900°Cの温度で形成したものである。
この半導体層性このCVD(CHEMICAL VAPOR DIPO- ( )
SITION)は本発明者の発明による特公昭51—1389に基
ずいて実施した。さらにまだは本発明人の出感になるグロー放
電法、プラズマ0VD法等特別昭53—067507(昭和
53年6月8日提出)に基ずいて実施した。かかる方法により

(10)

形成された半導体(1)は非単結晶半導体よりなり、かつその半導体中に選択的にまたは基板装面の被略平行にPB接合、PIB 接合、PBPB・・・PBの多重接合が形成されており、さらにまたはかかる非単結晶半導体には絶縁ゲイト型電界効果トラングスタまたはその集積化した半導体装置が設けられている。例えば本発明人の発明になる出額53-124022 (昭和53年10月7日) に記されている。

かかる非単約品半導体に対し、選択的にまたは全面に第1回 (A)と同談のエーアニールを行なりと、半導体表面または表面より2~3 mの原さまでの松子欠陥を格子を構成する元素同志を 総合させることにより1/10~1/10にその密度をすることができた。しかし同時にかかる半導体を構成していた元章と 水彩等とが結合して中和して不対結合手はその一部が81一日 結合よる81一位がたつて不対結合手を発生させてしまつた。 この時水素は81一日より水素どりしが互いに結合しあいると して半導体中に安定を状態で残つているのみであることがわか った。すなわち

過程1 81-8+8-81 → 81-81+8

64

10~1000 M W) を用いても同様である。その結果できた は 8型の不純物がドープされていない状態の真性半導体 (との 場合はパツクグラウンドレベルの不純物のドーブがある場合の 半導体をも含む) 化かいてその欠陥密度が1 o'c m'より1 o'~ 10°c 元代まで下げることができた。しかし半導体として用い るためには、この密度を10~10°cmまたはそれ以下に下げ る必要がある。さらにまた半導体層の表面より探い郊分での密 度も同様に下げるため、本先明においてはとのエーナニールと う同時ミたはその後に防導アニールを加えたととを特徴としてい る。との誘導アニールはマイクロ波により益根より離れた位置 ※※) にてあらかじめ前記した中和物を化学的に励起しそれを基板上 にまで導びいてもよい。マイクロ放は30~200里の出力で 例えば2.46日日を用いた。反応系は1気圧以下例えば 0.01~1070ァッとし、その雰囲気は水素または水菜に ヘリユームを30~50多添加した中和物を用いた。かかる雰 囲気中に本半導体装置を10分~1時間設置することにより、 前記した欠陥密度は10~1 dc dにまで下げることができた。 この欠陥密度はその被膜の作製方法がクロー放電法、プラズマ

・過程2 S1-H+H-S1 → 2S1-+H<sub>2</sub>

この通程20多い場合はかえつて再結合中心の密度を通程と1 では 大よりより単結晶化化近ずけたにもかかわらず増加させてしま は うことが判明した。換管すれば過程1により建設同志が互いに 共有結合をし、単結晶に近ずくため電気伝導度は約100倍に も増加したにもかかわらず、再結晶中心の密度はクロー放電等 で作られた袪膜にあつては10-アニール前が10~10で ㎡に 対し10~10で ㎡とこの半導体中での水素の含有量は約20 を30モルダとそまであるにもかかわらずーけたも増加してし まうことがわかつた。すなわちこの事実は放耀した水素は水素 同志結合しきわめて短い時間では、その水素が再び珪素の不対 結合手と結合しきれないことがわかつた。

また誠正のVD法等で形成された非単鉛品の半導体被膜はあらかじめ再結合中心中和物が含有していないため、L一丁ニールによりその結晶粒界を10~1000Aより0.1g~50gにまで大きくしより単粒晶化させることができた。それにレーザとして前配したのΨ発掘ではなく、パルス中が10~100~20例とは~15~4000ピーレーザ、ガラスレーザ(出力 /

C ▼ D 法、クラスタ素潜法、該圧 C ▼ D 法または真空素着法、 イオンプレーテイング法等には無関係となり、本発明の L ー T ニールと誘導アニールとを合わせることにより作製方法にはあ まり依存することなく半導体の木来あるべきへ強にまで近ずけ

第2 図は本発明の他の実施例であり、半導体上に透明電镀を (1) (4) 形成した場合を示す。

るととができた。

第2個(A)において、基板(3)はガラス、セラミックまたはガラーエボ等の複合材、カブーン、ボリイミド等の有機物の絶縁基板、「たみにさらにステンレス・スタール、テタンまたは近化チタン等のボーフ・14 体表板、さらに前配した絶縁基板上に選択的に活体を設けた複合基板であつてもよい。これらの基板上に半導体層(1)を非単結品構造に形成した。この半導体の作製方法はブラズマCVD法を用い、珪化物を主成分とした。この半導体中にはPB接合、PIBI・・・IPIB多重接合を形成した。半導体層の厚さは0.5~
5 Pの厚さである。さらにこの上面にご化スズ、ほ化インジュウム、吸化アンチモンまたはそれらの混合物をさらにまたはス

アンチモンの宝化物またはそれらの混合物 よりなる滞電質のを電気として同様のプラスマCVD法により 0.45~5 μの厚さに作製した。この導電層は光学的に近明で あり、レーザ光、可視光に対する光板 & が小さいことを特徴 ノギョ。 としている。さらにとの仏化対しエーアニールを加え的に示さ (c) (c) (c) (c) ためれる如く透明電極(のと半導体版(のの境界に選移領域を設け、導子域)。 場所の保成物の一部であるスズまたは度派さらに半導体中でP 5年的 型の導電型を示すインジューム (In)、 ガリユーム (Ga)、T ルミニユー KA1)、ボロン四、または亜鉛 (Zc)、カドミユー (ca) が添加油として添加された。 砂に単体では金属は特性を 有し、半場体中ではP型帯電型を有するInstateのInとBと 341E の協合の添加物はとの選移領域でのP型の導電率をきわめて高 マナるの化効果がらつたo この Iーナニールは I n、 Bの金 M /: そをその溶融限界である10°c mの支援より10~10倍高め 通温和の状態でかつ偏折をおとさせないという特徴を有し、10<sup>6</sup>7 ~30モル多特化0.3~3モル乡の添加はホールに対する不 純物が飲乱をおこさせることなく導電率を高めるのにきわめて 効果があつた。本発明はとの依さらにこのL―ナニ―ルにより

また透明電極下の半導体を B 型にせんとするならば、透明電極への振加物をアンチモン (B b) に来 (A e)、リン(P)、の如き V 価の添加物またはテルル (T e)、センン(B e)、の如き V 価の添加物またはテルル (T e)、センン(B e)、の如き V 価の添加物またはテルル (T e)、センン(B e)、の如き V 価の添加物の設定に添加するは 宝化スズの透明電極に 1 0~30 モルダ パッドル の速度に添加すればいい。 この添加物のうち特に B b または B b と P との混合物は L ー アニールに L り 同様に その電極直下の半準体層を B 型化しかつその添加量の固整限 字をこえて 透底にし バッド ても 偏折を かこすことなく 100 ダに近い活性度を 4 2 B 型と することができた。

66

第2図(C)は透明電極(2)を下側に形成しかつ半導体層(1)を上側 に形成させた場合である。かかる場合差板(2)がガラス等であつ た場合は下側からのレーザ光の入射によるアニールが好ましい。 しかし半導体階がロ・05~2 x とうすい場合は上側から半導体 層を通してのひ一アニールを行なつてもよい。

その結果第2回回と同様に選移領域(3が形成された。レーザを 光の照射方向により半導体層はその結晶数程が大きくなり、下 領から照射された場合は半導体層の下部が大きく上部が小さい 状態に、第2回回と同様に上颌から限射されると半導体層(1)の 上部が大きく下部が結晶として小さくなる。これより深さ方向 をこれが可引 の結晶数径をレーザ光の照射向をにより割倒できることがわか。対象 つた。

第2 図的は透明電極が上側(2)、さらド下側(4)化半導体層(1)を はさんで形成させた場合である。その結果エーアニール化より またで、(4)はP型にまた(6)はB型に作りいわゆるPー1接合を遠 当に作ることができた。もちろん図面の実施例にかいては下側 電低(4)を8 nと8 bとの化合物より作つた導体電極が基板上の 下地14 上に形成し、上側からのレーザ光の下側電極の反射を 利用してこの電極の一部を半導体層に添加する方法をとつても よい。逆にBIP接合を作ることも添加物と上側の電極がV、 別価の添加物を有し下側の電極がIIまたはII面の添加物を有す るといい。

これらのユーアニールの後半導体層全体化おけるレーアニールにより発生した不対結合手を再結合中心中和物であるH、H。 等の誘導アニールにより中和して電気的に不活性にすることは 半導体装額として動作させるためにはきわめて重要なことである。

第2回(A)、(内にかいては、若板上または半導体層上に当また だけ 型の導電型の半導体層を作るととを、またこの半導体層内 に P 単接合その他の接合を作ることを中記しなかつた。しかし C V D 法、 ブラズマ O V D 法、 グロー放電法等にかいては、 とれらの導電型の半導体は半導体层の形成と同時に添加して作製 ければよい。またこの優度が固溶限界をこえ、また非単結晶半 導体にかいてはその活性度が 3~50 多しかないため、これらは L ー アニールを行立うことより 50~100 多にすることが 存在でき、きわめて半導体としての構造機感性を有せしめることが できるようになった。

第2回例は透明電極を導体層上に選択的に設けた一例である。

44

の基度でおれるように平行平板方式であつてもよかった。かく を持たすることによってチアンパ内に放電がおとり、発生基の化学的 (株成性状態にある水果その他が特殊中にドープさせ、不対結合手と結合して中和させることがでれた。加えて従来エーアニー (水水) かは空気中においてのみ得えなかったが、かくすることにより (株を ロッカル・ステーン 大泉中、不活性ガス中で実施することができ、その結果照射面 ロサルル 上にリング状のエーアニール特有のしまもようの発生を減少させることができた。

本発明にかいてはエーアニールに用いられたのはなスイッチベルス発振レーザまたはCTレーザを用いたが、これと同様の効果をもたらすものにフラッシュ等の発生をキセノン等のランプを用いて行なつてもよい。その基板はきわめて長い昇張と降となったで行なうことにより、半導体または半導体中の添加物で、2017年底を行なうことにより、半導体または半導体中の添加物で、2017年底が等大きな必動を行いえず、熱アニール法にかける固落限界以上の最近の不純初または添加物を半導体中に添加させることをプロジェを敬としている。

本ி明のこれまでの実施例において、透明電極はそのまま残

その結果シアロ一接合(5~200 A)(I)の如く(5)(s)を作るととができた。

第3四は本発明を実施するための製造設置の一例である。四面に基プいてとれまで通り記述を行ないながら装置の概要を説明する。

m

置せしめている。しかしとの記憶を一度エッテンク数で徐去し 再度新しい透明電極を形成させてもよいことはいうまでも立い。 まいますな見まないますといい。 また第一の透明電便を100~1000名の厚さに形成した技 本表表表表表表 光アニールをし、さらに第二の透明電極で0、1~2 μの灯さくまれ に形成してもよい。

また本発明のとれまでの実施例は半導体は速素を主体として 説明した。しかし81xGe -- x (0 < x < 1)、81x8n -- x (0 < x < 1)、81xC -- x (0.5 < x < 1)または8n の如き N 族 の半導体またはG = A s、G = A 1 A s 等の B、V 族の化合物 半導体、さらにまたは半導体の一部に81x0x-x (0 < x < 8) 81x84-x (0 < x < 4) 等の低級酸化物、低級強化物がかかる 半導体の一部に形成させ、そのエネルギーバンド中を達定的に B-- 3 構造に変化させた。 端体を用いてもよいことはいりまで / +n... もない。

本発明の実施例において透明電極は液化スズ、酸化インジュ ウムまたは酸化アンテモン等の酸化物等電性透明電極を主とし て配した。しかし化学的にさらに安定な変化物の導電性透明電 pilk 極を強化スズ、強化インジューチ、強化アンチモン、強化チタ

2

Ð,

特扇昭56- 23748(7)

年1回

ン、窓化グルマニュームを用いてもよく、さらだ塩化珪素とと れらの混合物を導電性透明電極として用いてもよい。

加えて半導体値と取化物設明電極との境界に10~50Åの トンネル電流を放すをわめてりすい膜厚の短化珠素を設けた半 導体装盤にも本発明を適用できるととはいりまでもない。

さらに本発的における半導体装置は光電変換装置、特に太陽 性他のみではなく、MISPBTを用いた集制回路、製光点子、 ではよるは何のである。それを重要を 半導体レーザでの他トランジスタ、ダイボード等のすべての半、 連体装置に適用できるととはいうまでもない。

## 4.図面の簡単な説明

(A)

(0)

(E)

'(4)

第1回は本茲明を実施するための半導体装置の例をがす。 第2回は本ி明の他の実施例を示すための半導体装置の例を 示す。

第3図は本発明と実施するための製造装置の一例である。

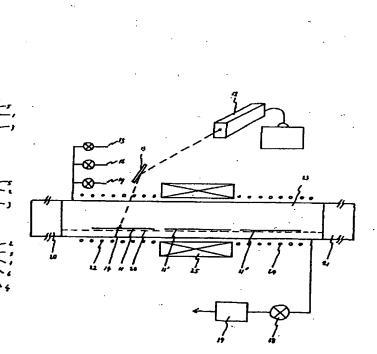
特許出顏人

山崎舜平、

(B)

co)

(2)



半1回

**其2**例

\* (H)